



RW610FML: 集成MCU的高性能Wi-Fi 6+BLE组合模块

RW610FML NEW

Preproduction

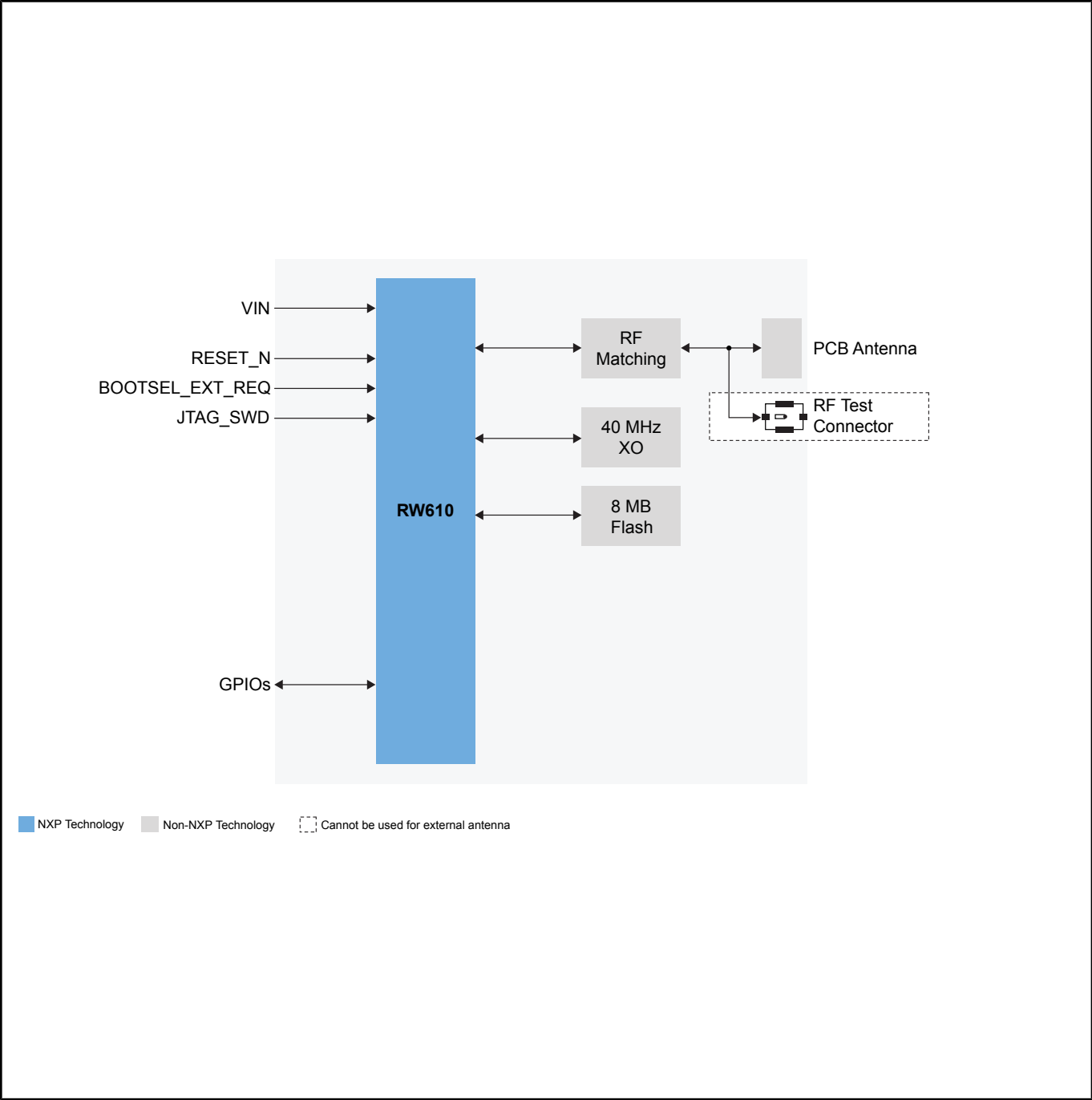
本页介绍的产品处于样品阶段。此处的产品技术规格和信息如有变更，恕不另行通知。如需了解更多信息和样品供货情况，请联系恩智浦 支持服务或恩智浦当地销售人员。

Last Updated: Aug 13, 2026

RW610FML是一款低功耗、高性能Wi-Fi 6+蓝牙组合模块，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax协议及低功耗蓝牙协议。该模块集成了丰富的外设接口，可实现灵活设计，广泛适用于物联网和消费电子设备。

RW610FML模块基于RW610构建，后者是一款高集成度的低功耗无线MCU，集成了MCU及Wi-Fi 6+BLE无线通信单元。RW610 MCU子系统搭载了260MHz Arm® Cortex®-M33内核，带有Trustzone™-M、1.2MB片上SRAM和高带宽4通道SPI接口，该接口具有即时解密引擎，支持安全地访问片外XIP闪存。

RW610FML Block Diagram



View additional information for [RW610FML](#): 集成MCU的高性能Wi-Fi 6+BLE组合模块.

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2026 NXP B.V.